

Presseinformation

27.03.2013

Henkel auf der SMT Hybrid Packaging 2013 in Nürnberg

Hochzuverlässige Lösungen für die Mikroelektronik

— Innovative elektronische Materialien sollen beim Einsatz unter schwierigen Umwelteinflüssen beständige Leistung erbringen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz der Produktion steigern. Für diese zentralen Ansprüche, die insbesondere, aber nicht ausschließlich in der Automobilindustrie gelten, hat Henkel eine differenzierte Produktpalette von hochzuverlässigen Klebstoffen, Lötmaterialien und Underfills entwickelt. Innovationen aus diesen Bereichen stellt Henkel auf der SMT Hybrid Packaging vor, Europas größter Fachmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik, die vom 16. bis 18. April in Nürnberg stattfindet.

— „Vor allem in der Automobilindustrie fordern Elektronikspezialisten zunehmend robuste Klebstoffe, die selbst unter schwierigsten Bedingungen verlässliche Leistungen sicherstellen“, so Tom Adcock, Global Product Manager für Montageklebstoffe bei Henkel. „Wir haben mit Loctite Ablestik ICP 4000 ganz gezielt ein Portfolio silikonbasierter ECA-Klebstoffe für elektronische Sensoren entwickelt, die sich in Fahrzeugen immer näher an Hitze und Vibrationen erzeugenden Quellen befinden.“

— Dank ihrer Flexibilität gegenüber Vibrationsenergie erhalten die Klebstoffe der Loctite Ablestik ICP 4000 Serie sogar bei dauerhaften Erschütterungen ihre hohe Klebkraft und Leitfähigkeit. Auch in Bezug auf hohe Betriebstemperaturen sind sie den bisher eingesetzten epoxidbasierten Materialien deutlich überlegen: Bei Temperaturen bis 200 Grad Celsius bieten die einkomponentigen, silbergefüllten Silikonklebstoffe einen stabilen Kontaktwiderstand.

Ausfallsichere Verbindungen und günstigere Montageprozesse

Weitere Innovationen im Bereich der einkomponentigen elektrisch leitfähigen Klebstoffe sorgen für ausfallsichere Verbindungen, vereinfachen Montageprozesse und reduzieren Produktionskosten. Mit Loctite Ablestik ICP 3540 ist Henkel die Entwicklung eines vielseitigen Epoxid-Klebstoffs gelungen, der insbesondere in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Er befestigt in einem einzigen Prozessschritt sowohl Chips als auch andere Komponenten und ist sowohl auf organischen als auch keramischen Substraten anwendbar. Das spart nicht nur Zeit, sondern führt vor allem zu einer deutlichen Reduktion der Betriebskosten. Dabei zeigt der Klebstoff weder Delaminationseffekte unter großen Chips, noch Brückenbildung oder „Wicking“ bei sehr kleinen Bauteilen wie 0402. Mit diesem neuen Material komplettiert Henkel sein Portfolio von vielseitigen und zuverlässigen Klebstoffen für kosteneffektivere Produktionsprozesse.

Halogenfreies Produktportfolio mit hochzuverlässiger Leistung

Mit seinen halogenfreien Produkten stellt Henkel Lösungen bereit, die sogar unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen mit hochzuverlässigen Leistungen überzeugen – von Flussmittelsystemen über Lötpasten bis hin zu Underfills. Das aufeinander abgestimmte Produktportfolio ermöglicht eine optimale Anpassung an kundenspezifische Produktionsanforderungen aus einer Hand.

Die halogen- und bleifreie Lötpaste Loctite Multicore HF 200 zeichnet sich insbesondere durch ihre hervorragende Druckfähigkeit in Hochgeschwindigkeitsprozessen aus. Dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit und geringen Neigung zur Void-Bildung hat sich das Produkt bereits in zahlreichen Lötprozessen bewährt, unter anderem für Handheld-Geräte. Das marktführende bleifreie Flussmittelsystem Loctite Multicore LF 318 verfügt über eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsresistenz und ein breites Verarbeitungsfenster in Bezug auf Reflow-, aber auch Druckprozesse. Sowohl in verschiedenen Reflow-Verfahren als auch auf verschiedenartigen Oberflächen bietet das halogenidfreie Produkt hervorragende Löteigenschaften.

Die beiden Lötpasten Loctite Multicore HF 200 und Loctite Multicore LF 318 sind kompatibel mit den bleifreien Lötlegierungen, die Henkel unter anderem für anspruchsvolle Hochtemperaturanwendungen anbietet: Dieses leistungsstarke System gewährleistet damit ein hochzuverlässiges Ergebnis für eine große Bandbreite an Lötprozessen.

Während der SMT Hybrid Packaging vom 16. bis 18. April 2013 informieren Henkel-Experten in Halle 9, Stand 353, über das vielfältige Portfolio des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.com/electronics.

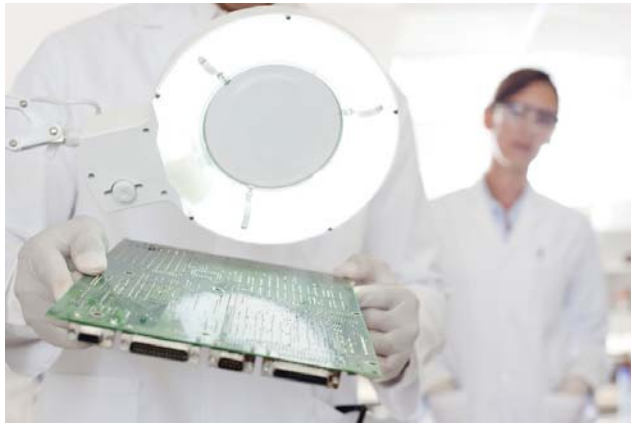
Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte Henkel einen Umsatz von 16.510 Mio. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2.335 Mio. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

| | | |
|---------|--|--|
| Kontakt | Lisa Kretzberg | Holger Elfes |
| Telefon | +49 211 797-56 72 | +49 211 797-99 33 |
| E-Mail | lisa.kretzberg@henkel.com | holger.elfes@henkel.com |

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Henkel hat eine differenzierte Produktpalette von hochzuverlässigen Klebstoffen, Lötmaterialien und Underfills entwickelt.